

芯片底部填充胶

产品名称	芯片底部填充胶
公司名称	深圳市聚芯源新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道白石厦社区东区龙王庙工业区A8栋101
联系电话	13537566612 18028708139

产品详情

、底部填充施胶工艺

添加底部的步骤通常会被安排在电路板组装完成，并且完全通过电性测试以确定板子的功能没有问题后才会执行，因为执行了underfill 之后的晶片就很难再对其进行修理(repair)或重工(rework)的动作。

Underfill底部填充工艺流程如下图所示。

(1) 烘烤环节

烘烤环节主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前，如果主板不干燥，容易在容易在填充后有小气泡产生，在的固化环节，气泡就会发生爆炸，从而影响焊盘与PCB之间的粘结性，也有可能导致焊锡球与焊盘的脱落。

(2) 预热环节

对主板进行预热可以提高Underfill底部填充胶的流动性。但是反复的加热势必会使得PCBA质量受到些许影响，所以建议这个环节建议温度不宜过高，建议预热温度在40~60 。

(3) 点胶环节

底部填充胶水使用时需依据器件大小和填充要求调试出胶量，按选定的路径点胶，通常情况下，不建议采用“U”型作业，通常用“—”型和“L”型，因为采用“U”型作业，通过表面观察的，有可能会形成元件底部中间大范围内空洞。底部填充胶水因毛细管虹吸作用按箭头方向自动填充，需设定胶量按设定的路径点胶使其快速填充，要求在点胶的对边有胶溢出，四边的点胶最低限度覆盖住器件焊球。目前较为流行的底部填充方案主要有三种，即：完全底部填充法、边缘底部填充法和边角绑定填充法。